本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号 ： PCN#20100105000
2010 年 1 月 8 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎

TPS20xxx 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

― 記 ―

通知タイプ	□Initial notice (Plan)	■Final notice		
変更概要	Design/Specification	□Design	□Electrical	□Mechanical
	Wafer Fab	□Site	□Process	□Material
	Wafer Bump	□Site	□Process	□Material
	■Assembly	□Site	■Process	■Material
	Test	□Site	□Process	
	Others	□Packing/Shipping/Labeling		□ -
変更内容	TPS20xxx 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 ：Au(金)線 ボンディングワイア 変更後：Cu(銅)線 ボンディングワイア			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	4 月中旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	□計画	■終了		
製品表示	■変更無し	□変更あり		
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 PWR(パワーマネジメント) TPS20xxx 一部製品について、現行 Au(金)線 ボンディングワイアを使用して製造していますが、ボンディングワイアの機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為に、これに替わり、Cu(銅)線 ボンディングワイアへ移行し認定しました。対象製品について、ボンディングワイア以外の部材及び組立サイトの変更はありません。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差),外観,動作特性,品質,信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
ボンディングワイア	Au(金)線	Cu(銅)線

理由：機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為

対象製品リスト

対象製品名				
HPA00095BDR	TPS2043BD	TPS2047BD	TPS2052BD	TPS2061DRG4
HPA00129BDR	TPS2043BDG4	TPS2047BDG4	TPS2052BDG4	TPS2062ADR
HPA00596BDR	TPS2043BDR	TPS2047BDR	TPS2052BDRG4	TPS2062ADRG4
TPS2041ADG4	TPS2043BDRG4	TPS2047BDRG4	TPS2053ADR	TPS2062D
TPS2041ADRG4	TPS2044ADG4	TPS2048AD	TPS2053ADRG4	TPS2062DG4
TPS2041BDG4	TPS2044ADRG4	TPS2048ADG4	TPS2053BDR	TPS2062DR
TPS2041BDRG4	TPS2044BD	TPS2048ADR	TPS2053BDRG4	TPS2062DR-1
TPS2042AD	TPS2044BDG4	TPS2048ADRG4	TPS2054AD	TPS2062DR-1G4
TPS2042ADG4	TPS2044BDR	TPS2049D	TPS2054ADG4	TPS2062DRG4
TPS2042ADR	TPS2044BDRG4	TPS2049DG4	TPS2054ADR	TPS2066ADR
TPS2042ADRG4	TPS2045AD	TPS2049DR	TPS2054ADRG4	TPS2066ADRG4
TPS2042BDG4	TPS2045ADG4	TPS2049DRG4	TPS2054BDR	TPS2066DR
TPS2042BDR	TPS2045ADR	TPS2051ADG4	TPS2054BDRG4	TPS2066DRG4
TPS2042BDRG4	TPS2045ADRG4	TPS2051ADRG4	TPS2055ADG4	TPS2068DR
TPS2043AD	TPS2046ADG4	TPS2051BDG4	TPS2055ADRG4	TPS2068DRG4
TPS2043ADG4	TPS2046ADRG4	TPS2051BDRG4	TPS2061D	
TPS2043ADR	TPS2046BDR	TPS2052ADG4	TPS2061DG4	
TPS2043ADRG4	TPS2046BDRG4	TPS2052ADRG4	TPS2061DR	

信頼性試験

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 11 月 18 日

信頼性試験 – 試料構成詳細			
Qual Device:	TPS2041BD	Die Sizes (mm):	1.47 X 0.73
Assembly Site:	FMX	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4205694
Bond Wire:	1.98 Mil Dia. Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC LEVEL-1 / 260C	-	-

信頼性試験結果		
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails
**Thermal Shock	-65/150C, 500 Cycles	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs.	77/0
High Temp Storage Bake	170C, 420 Hrs.	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	77/0
**Life Test	155C, 240 Hrs.	77/0
Manufacturability (Assembly)	per assembly site spec	Approved
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-1 / 260C		

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 11 月 18 日

信頼性試験 – 試料構成詳細			
Qual Device:	TPS2044BD	Die Sizes (mm):	1.472 X 2.120
Assembly Site:	FMX	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4205694
Bond Wire:	1.98 Mil Dia. Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC LEVEL-1 / 260C	-	-

信頼性試験結果		
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails
**Thermal Shock	-65/150C, 500 Cycles	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs.	77/0
High Temp Storage Bake	170C, 420 Hrs.	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	77/0
Manufacturability (Assembly)	per assembly site spec	Approved
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-1 / 260C		

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2009 年 11 月 18 日

信頼性試験 – 試料構成詳細			
Qual Device:	TPS2062AD	Die Sizes (mm):	1.472 X 1.076
Assembly Site:	FMX	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4205694
Bond Wire:	1.98 Mil Dia. Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC LEVEL-1 / 260C	-	-

信頼性試験結果		
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails
**Thermal Shock	-65/150C, 500 Cycles	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hrs.	77/0
High Temp Storage Bake	170C, 420 Hrs.	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 500 cycles	77/0
**Life Test	155C, 240 Hrs.	77/0
Manufacturability (Assembly)	per assembly site spec	Approved
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC Level-1 / 260C		